**Pressemitteilung**

Nr.: REN2437(A)

**Renesas präsentiert die erste vollständige Chipsatzlösung der Branche für Speicherschnittstellen der zweiten Generation von DDR5-Server-MRDIMMs**

*Neuer Multiplexed Registered Clock Driver, Multiplexed Data Buffer und PMIC ermöglichen Next-Generation MRDIMM mit Geschwindigkeiten von bis zu 12800 Megatransfers pro Sekunde für KI- und Hochleistungs-Computing-Anwendungen*

**Düsseldorf, 20. November 2024 –** Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), ein führender Anbieter innovativer Halbleiterlösungen, stellt die erste vollständige Chipsatzlösung für Speicherschnittstellen der zweiten Generation von DDR5-MRDIMMs (Multi-Capacity Rank Dual In-Line Memory Module) vor.

Die neuen DDR5-MRDIMMs sind erforderlich, um mit den ständig wachsenden Anforderungen an Speicherbandbreite für Künstliche Intelligenz (KI), Hochleistungs-Computeranwendungen (HPC) und anderen Anwendungen in Rechenzentren Schritt zu halten. Sie liefern eine Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 12800 Megatransfers pro Sekunde (MT/s). Dies entspricht einer 1,35-fachen Verbesserung der Speicherbandbreite gegenüber den Lösungen der ersten Generation. Renesas war maßgeblich am Design, der Entwicklung und dem Einsatz der neuen MRDIMMs beteiligt. Dabei arbeitete das Unternehmen mit Branchenführern wie CPU- und Speicherherstellern sowie Endkunden zusammen.

Renesas hat drei neue zentrale Komponenten entwickelt und produziert: Den RRG50120 Multiplexed Registered Clock Driver (MRCD) der zweiten Generation, den RRG51020 Multiplexed Data Buffer (MDB) der zweiten Generation und den RRG53220 Powermanagement-IC (PMIC) der zweiten Generation. Darüber hinaus bietet Renesas Temperatursensoren (TS) und SPD-Hub-Lösungen (Serial Presence Detection) in Serienproduktion an. Damit ist Renesas der einzige Speicherschnittstellen-Hersteller, der vollständige Chipsatzlösungen für den Industriestandard Next-Generation MRDIMMs und auch für andere Server- und Client-DIMMs bereitstellt.

„Die Nachfrage nach Hochleistungssystemen, die von KI- und HPC-Anwendungen getrieben werden, ist ungebrochen“, so **Davin Lee, Senior Vice President und General Manager von Analog & Connectivity & Embedded Processing.** „Renesas steht an der Spitze dieses Trends und arbeitet mit Branchenführern zusammen, um Technologien und Spezifikationen der nächsten Generationen zu entwickeln. Diese Unternehmen verlassen sich darauf, dass Renesas das technische Wissen und die Produktionskapazitäten bereitstellt, die sie benötigen, um der beispiellosen Nachfrage zu begegnen. Unsere neueste Chipsatzlösung für DDR5- MRDIMMs der zweiten Generation untermauert unsere Führungsposition in diesem Markt.“

Der MRCD der zweiten Generation RRG50120 von Renesas wird in MRDIMMs eingesetzt, um den Command-Address-Bus (CA-Bus), die Chip-Auswahl (Chip-Selects) und den Taktgenerator zwischen dem Host-Controller und den DRAMs zu puffern. Im Vergleich zur ersten Generation ist die Leistungsaufnahme um 45 Prozent geringer, was für das Wärmemanagement in Hochgeschwindigkeitssystemen von entscheidender Bedeutung ist. Der RRG51020 Gen2 MDB ist die andere Schlüsselkomponente, die in MRDIMMs genutzt wird, um Daten zwischen der Host-CPU und den DRAMs zu puffern. Sowohl der neue MRCD als auch der MDB von Renesas unterstützen bis zu 12,8 GBytes pro Sekunde (Gbps). Zusätzlich bietet Renesas mit dem RRG53220 einen PMIC der nächsten Generation, der sich durch den besten elektrischen Überlastungsschutz seiner Klasse sowie einen herausragenden Wirkungsgrad auszeichnet. Er ist für den Betrieb bei geringen Versorgungsspannungen und hohen Strömen optimiert.

**Verfügbarkeit**

Renesas bemustert derzeit die neuen Komponenten RRG50120 MRCD, RRG51020 MDB und RRG53220 PMIC. Die neuen Produkte werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in Produktion gehen. Weitere Informationen zu den neuen Produkten unter: [renesas.com/DDR5](https://www.renesas.com/en/products/memory-logic/memory-interface-products/ddr5-solutions?utm_campaign=mid_mrdimm-&utm_medium=pr&creative=pr&utm_content=lp&type=pron)

**Über Renesas Electronics Corporation**

Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) engagiert sich für eine sicherere, intelligentere und nachhaltigere Zukunft, in der Technologie das Leben der Menschen vereinfacht. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Mikrocontrollern vereint Renesas sein Know-how in den Bereichen Embedded Processing, Analog & Power sowie Connectivity und stellt ein umfassendes Portfolio an Halbleiterlösungen bereit. Diese Winning Combinations beschleunigen die Markteinführung von Automotive-, Industrie-, Infrastruktur- und IoT-Anwendungen. Renesas ermöglicht damit Milliarden von vernetzten, intelligenten Lösungen, die die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen verbessern. Weitere Informationen unter: [renesas.com](https://www.renesas.com). Folgen Sie Renesas auch auf [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/renesas/), [Facebook](https://www.facebook.com/RenesasElectronics/), [X](https://twitter.com/renesasglobal), [YouTube](https://www.youtube.com/user/RenesasPresents) und [Instagram](https://www.instagram.com/renesas_global/).

###

Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Namen von Produkten oder Dienstleistungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

**Medienkontakt für weitere Presseinformationen, Bildmaterial oder Artikelanfragen:**

Alexandra Janetzko

HBI Communication Helga Bailey GmbH (PR-Agentur), Hermann-Weinhauser-Str. 73, 81673 München

Tel.: +49 89 99 38 87-32

E-Mail: [alexandra\_janetzko@hbi.de](mailto:alexandra_janetzko@hbi.de)

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)